

深圳华强实业股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：截至本公告披露日，深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及控股子公司累计的对外担保余额为人民币 719,595 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 100.32%。本次担保的被担保人之一华强半导体有限公司（以下简称“香港半导体”）资产负债率超过 70%，但香港半导体是公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、担保人：深圳华强实业股份有限公司

2、被担保人：湘海电子（香港）有限公司（以下简称“香港湘海”）、淇诺（香港）有限公司（以下简称“香港淇诺”）、芯斐科技（香港）有限公司（以下简称“芯斐科技”）、芯斐电子（香港）有限公司（以下简称“香港芯斐”）、联汇（香港）有限公司（以下简称“香港联汇”）、香港半导体，其中香港湘海、香港半导体为公司全资子公司，香港淇诺、芯斐科技、香港芯斐、香港联汇为公司控股子公司。

3、担保基本情况介绍

根据各被担保人业务开展的实际需要，公司于 2021 年 4 月分别为香港湘海、香港淇诺、芯斐科技、香港芯斐向恒生银行有限公司（以下简称“恒生银行”）申请的贷款或授信提供了担保（相关担保的具体情况详见公司于 2021 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》）；公司于 2022 年 6 月为香港联汇和香港半导体（以下统称“联名被担保人”）共同向恒生银行申请联名授信提供了担保（相关担保的具体情况详见公司于 2022 年 6 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

为控股子公司提供担保的公告》)。鉴于前述担保(以下统称“原担保”)即将到期,为保障各被担保人业务的正常开展,公司与恒生银行重新签订了担保文件,担保期限均为自担保文件签署之日起至2027年7月31日(担保的主要内容详见本公告“三、担保的主要内容”)。前述新担保文件生效的同时,原担保撤销。

本次担保发生额、撤销担保额如下:

(单位:人民币万元)

序号	被担保人名称	担保发生额	撤销担保额
1	香港湘海	57,600	54,400
2	香港淇诺	39,240	37,060
3	芯斐科技	6,120	5,780
4	香港芯斐	4,320	4,080
5	香港联汇、香港半导体(联名被担保人)	14,400	14,000

注:上表中的担保发生额按1美元兑人民币7.2元的汇率折算而成。

4、被担保人相关担保额度审议情况

公司于2024年3月14日召开董事会会议、2024年4月1日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》,预计公司和/或控股子公司自2024年4月1日起未来十二个月,为资产负债率低于70%的控股子公司向银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等提供人民币389,632万元的担保额度,为联名被担保人等公司控股子公司中的两家或两家以上的公司向银行申请联名授信提供人民币294,120万元的担保额度(以下统称“预计担保额度”)。该议案的具体内容详见公司于2024年3月16日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告》。

本次担保及本次撤销担保之前公司和/或控股子公司对香港湘海、香港淇诺、芯斐科技、香港芯斐的担保余额分别为人民币246,120万元、54,340万元、16,580万元、12,050万元,本次担保及本次撤销担保之后公司和/或控股子公司对香港湘海、香港淇诺、芯斐科技、香港芯斐的担保余额分别为人民币249,320万元、56,520万元、16,920万元、12,290万元;本次担保及本次撤销担保之前公司和/或控股子公司对资产负债率低于70%的控股子公司的可用担保额度为人民币

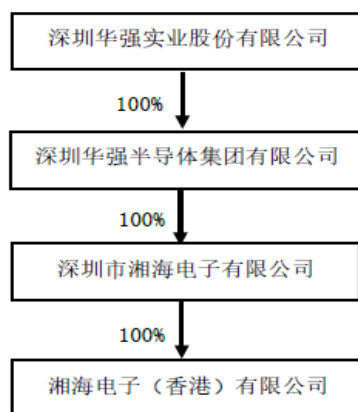
346,432 万元，本次担保及本次撤销担保之后公司和/或控股子公司对资产负债率低于 70%的控股子公司的可用担保额度为人民币 239,152 万元。本次担保及本次撤销担保之前公司和/或控股子公司对控股子公司向银行申请联名授信的担保余额为人民币 160,195 万元，可用担保额度为人民币 294,120 万元；本次担保及本次撤销担保之后公司和/或控股子公司对控股子公司向银行申请联名授信的担保余额为人民币 160,595 万元，可用担保额度为人民币 279,720 万元。

本次担保属于公司前述预计担保额度范围内的担保，根据股东大会的授权，公司董事长审批同意了本次担保及本次撤销担保相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项不需要提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）湘海电子（香港）有限公司

- 1、名称：湘海电子（香港）有限公司
- 2、住所：香港新界沙田火炭坳背湾街 38-40 号华卫工贸中心 18 楼 01-05 室和 13-15 室
- 3、成立时间：2012 年 9 月 19 日
- 4、主营业务：电子元器件授权分销
- 5、负责人：杨林
- 6、注册资本：3,220 万美元
- 7、与公司关系：湘海电子（香港）有限公司为公司全资子公司，与公司关系结构图如下：



8、主要财务指标：

(单位：人民币万元)

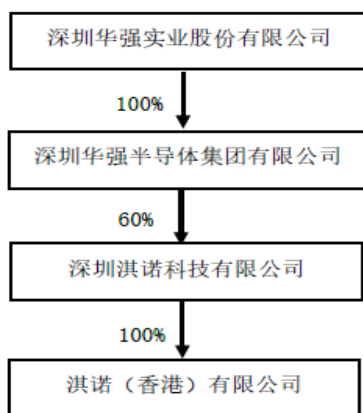
项目名称	2024年4月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	337,055.06	417,180.81
负债总额	150,683.08	233,269.82
其中：银行贷款总额	116,743.83	213,072.20
流动负债总额	150,227.46	232,848.35
归母净资产	186,371.98	183,910.99
或有事项涉及的总额	-	-
	2024年1月至4月(未经审计)	2023年1月至12月(经审计)
营业收入	187,200.13	701,968.61
利润总额	2,484.94	12,815.53
归母净利润	2,074.94	10,712.45

9、湘海电子(香港)有限公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒

(二) 淇诺(香港)有限公司

- 1、名称：淇诺(香港)有限公司
- 2、住所：香港新界沙田火炭坳背湾街38-40号华卫工贸中心5楼12-13室
- 3、成立时间：2015年8月26日
- 4、主营业务：电子元器件授权分销
- 5、负责人：陈辉军
- 6、注册资本：100万美元
- 7、与公司关系：淇诺(香港)有限公司为公司控股子公司，与公司关系结

构图如下：



8、主要财务指标：

(单位：人民币万元)

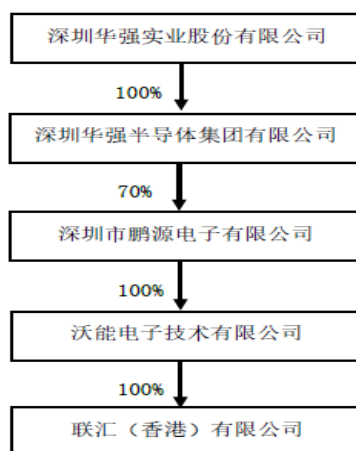
项目名称	2024年4月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	60,617.90	54,791.01
负债总额	26,421.21	22,053.49
其中：银行贷款总额	19,207.56	13,279.65
流动负债总额	26,421.21	22,053.49
归母净资产	34,196.69	32,737.52
或有事项涉及的总额	-	-
	2024年1月至4月(未经审计)	2023年1月至12月(经审计)
营业收入	50,853.86	134,605.05
利润总额	1,615.96	2,309.94
归母净利润	1,349.33	1,928.80

9、淇诺（香港）有限公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒

(三) 联汇（香港）有限公司

- 1、名称：联汇（香港）有限公司
- 2、住所：香港新界沙田火炭坳背湾街38-40号华卫工贸中心5楼12-13室
- 3、成立时间：2008年5月5日
- 4、主营业务：电子元器件授权分销
- 5、负责人：陈辉军
- 6、注册资本：5,200万港元
- 7、与公司关系：联汇（香港）有限公司为公司控股子公司，与公司关系结

构图如下：



8、主要财务指标：

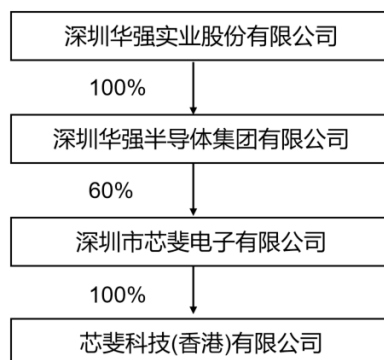
(单位：人民币万元)

项目名称	2024年4月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	44,983.40	45,822.99
负债总额	22,496.86	25,135.16
其中：银行贷款总额	0.00	2,840.64
流动负债总额	22,496.86	25,135.16
归母净资产	22,486.54	20,687.83
或有事项涉及的总额	-	-
	2024年1月至4月(未经审计)	2023年1月至12月(经审计)
营业收入	18,745.90	88,807.46
利润总额	2,078.90	4,940.62
归母净利润	1,737.53	4,109.31

9、联汇(香港)有限公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒

(四) 芯斐科技(香港)有限公司

- 1、名称：芯斐科技(香港)有限公司
- 2、住所：香港新界沙田火炭坳背湾街38-40号华卫工贸中心4楼11室
- 3、成立时间：2015年11月10日
- 4、主营业务：电子元器件授权分销
- 5、负责人：陈辉军
- 6、注册资本：500万美元
- 7、与公司关系：芯斐科技(香港)有限公司为公司控股子公司，与公司关系结构图如下：



8、主要财务指标：

(单位：人民币万元)

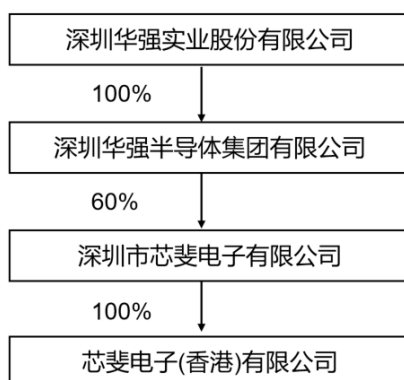
项目名称	2024年4月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	43,244.74	46,266.45
负债总额	19,891.52	23,745.63
其中：银行贷款总额	15,540.32	15,831.70
流动负债总额	19,891.52	23,745.63
归母净资产	23,353.22	22,520.82
或有事项涉及的总额	-	-
	2024年1月至4月(未经审计)	2023年1月至12月(经审计)
营业收入	50,697.28	108,616.72
利润总额	906.70	3,187.04
归母净利润	756.93	2,660.45

9、芯斐科技(香港)有限公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒

(五) 芯斐电子(香港)有限公司

- 1、名称：芯斐电子(香港)有限公司
- 2、住所：香港新界沙田火炭坳背湾街38-40号华卫工贸中心4楼11室
- 3、成立时间：2015年11月30日
- 4、主营业务：电子元器件授权分销
- 5、负责人：陈辉军
- 6、注册资本：200万美元

7、与公司关系：芯斐电子(香港)有限公司为公司控股子公司，与公司关系结构图如下：



8、主要财务指标：

(单位：人民币万元)

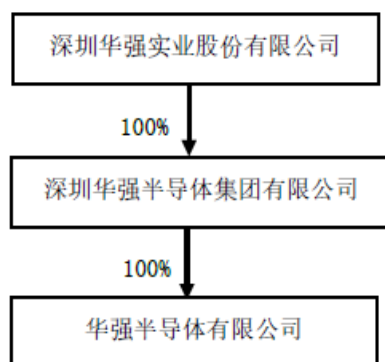
项目名称	2024年4月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	25,652.85	23,533.37
负债总额	17,200.13	15,168.20
其中：银行贷款总额	8,133.29	4,863.87
流动负债总额	17,200.13	15,168.20
归母净资产	8,452.71	8,365.18
或有事项涉及的总额	-	-
	2024年1月至4月(未经审计)	2023年1月至12月(经审计)
营业收入	11,794.07	50,177.29
利润总额	64.02	609.57
归母净利润	59.63	508.78

9、芯斐电子(香港)有限公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒

(六) 华强半导体有限公司

- 1、名称：华强半导体有限公司
- 2、住所：香港新界沙田火炭坳背湾街38-40号华卫工贸中心5楼12-13室
- 3、成立时间：2013年11月8日
- 4、主营业务：电子元器件授权分销
- 5、负责人：陈辉军
- 6、注册资本：6,000万美元
- 7、与公司关系：华强半导体有限公司为公司全资子公司，与公司关系结构

图如下：



8、主要财务指标：

（单位：人民币万元）

项目名称	2024年4月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	132,568.95	131,969.27
负债总额	95,609.15	98,435.71
其中：银行贷款总额	5,710.91	27,498.42
流动负债总额	95,548.91	98,341.46
归母净资产	35,715.23	33,126.21
或有事项涉及的总额	-	-
	2024年1月至4月（未经审计）	2023年1月至12月（经审计）
营业收入	105,645.56	231,321.62
利润总额	3,940.27	3,159.21
归母净利润	2,477.25	2,654.72

9、华强半导体有限公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒

三、担保的主要内容

（一）为香港湘海提供担保

- 1、担保事项：为香港湘海向恒生银行申请的贷款或授信提供担保。
- 2、担保方式：连带责任保证担保。
- 3、担保期限：自担保文件签署之日起至 2027 年 7 月 31 日。
- 4、担保金额：总金额不超过 8,000 万美元，折合人民币约为 57,600 万元。
- 5、被担保人其他股东同比例担保或反担保情况：香港湘海为上市公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

（二）为香港淇诺提供担保

- 1、担保事项：为香港淇诺向恒生银行申请的贷款或授信提供担保。
- 2、担保方式：连带责任保证担保。
- 3、担保期限：自担保文件签署之日起至 2027 年 7 月 31 日。
- 4、担保金额：总金额不超过 5,450 万美元，折合人民币约为 39,240 万元。
- 5、被担保人其他股东同比例担保或反担保情况：公司控制香港淇诺 60%的股权，其他合计控制香港淇诺 40%股权的股东未按其持股比例提供相应担保，但以最高额股权质押、最高额房产抵押的方式向上市公司提供连带责任反担保。

（三）为芯斐科技提供担保

- 1、担保事项：为芯斐科技向恒生银行申请的贷款或授信提供担保。
- 2、担保方式：连带责任保证担保。
- 3、担保期限：自担保文件签署之日起至 2027 年 7 月 31 日。
- 4、担保金额：总金额不超过 850 万美元，折合人民币约为 6,120 万元。
- 5、被担保人其他股东同比例担保或反担保情况：公司控制芯斐科技 60%的股权，其他合计控制芯斐科技 40%股权的股东未按其持股比例提供相应担保，但以最高额股权质押的方式向上市公司提供连带责任反担保。

（四）为香港芯斐提供担保

- 1、担保事项：为香港芯斐向恒生银行申请的贷款或授信提供担保。
- 2、担保方式：连带责任保证担保。
- 3、担保期限：自担保文件签署之日起至 2027 年 7 月 31 日。
- 4、担保金额：总金额不超过 600 万美元，折合人民币约为 4,320 万元。
- 5、被担保人其他股东同比例担保或反担保情况：公司控制香港芯斐 60%的股权，其他合计控制香港芯斐 40%股权的股东未按其持股比例提供相应担保，但以最高额股权质押的方式向上市公司提供连带责任反担保。

（五）为香港联汇、香港半导体提供联名担保

- 1、担保事项：为香港联汇、香港半导体共同向恒生银行申请联名授信提供担保，在任何时点，联名被担保人向恒生银行申请贷款或授信的未偿还总额不得超出 2,000 万美元（折合人民币约为 14,400 万元）。
- 2、担保方式：连带责任保证担保。
- 3、担保期限：自担保文件签署之日起至 2027 年 7 月 31 日。
- 4、担保金额：总金额不超过 2,000 万美元，折合人民币约为 14,400 万元。
- 5、被担保人其他股东同比例担保或反担保情况：

（1）香港半导体为公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况；

（2）公司控制香港联汇 70%的股权，其他合计控制香港联汇 30%股权的股东未按其持股比例提供相应担保，但以最高额房产抵押的方式向上市公司提供连带责任反担保。

四、董事会意见

1、本次担保的被担保人从事的主营业务为电子元器件授权分销，对资金的需求较高，高效、充足的资金保障有助于各被担保人开展并进一步开拓业务。在各种融资渠道中，银行融资是一种成本较低的融资方式，通过银行融资获取资金，可以充分发挥公司积累的优质资产和优良信用的无形价值。公司本次为各被担保人提供担保是为了确保各被担保人向境内外电子元器件生产商的采购的顺利进行，避免因资金规模受限而影响其业务开展和进一步开拓，符合各被担保人业务经营的实际需要。本次担保的被担保人均为公司全资子公司或控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。

2、除香港湘海、香港半导体为公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况外，本次担保的被担保人的其他股东均以最高额房产抵押和/或股权质押的方式向上市公司提供连带责任反担保。该反担保足以保障上市公司的利益，此次上市公司向被担保人提供担保符合公平、对等的原则，不会损害上市公司及全体股东的利益。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

在本次担保及本次撤销担保之前，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为人民币 713,235 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 99.44%；本次担保及本次撤销担保后，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为人民币 719,595 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 100.32%；本次担保后，公司及控股子公司的可用担保额度总金额为人民币 622,472 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 86.78%。

公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2024年7月10日